

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.25; 31.080.01; 31.240 **Červenec 2010**

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž

ČSN
EN 60191-6
ed. 2
35 8791

idt IEC 60191-6:2009

Mechanical standardization of semiconductor devices –
Part 6: General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages

Normalisation mécanique des dispositifs a semi-conducteurs –
Partie 6: Regles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des boîtiers pour dispositifs a semi-conducteurs pour montage en surface

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen –
Teil 6: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen von SMD-Halbleitergehäusen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60191-6:2009. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60191-6:2009. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-12-01 se nahrazuje ČSN EN 60191-6 (35 8791) z července 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje obecná pravidla pro přípravu výkresů polovodičových součástek pro povrchovou montáž. Nahrazuje IEC 60191-1 a IEC 60191-3. Pokrývá všechny typy diskretních polovodičových součástek pro povrchovou montáž s počtem vývodů vyšším nebo rovným 8 a rovněž integrované obvody v provedení E podle kapitoly 3 z IEC 60191-4.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-12-01 používat dosud platná ČSN EN 60191-6 (35 8791)

z července 2005, v souladu s předmluvou k EN 60191-6:2009.

Změny proti předchozím normám

Norma EN 60191-6:2009 obsahuje oproti normě EN 60191-6:2004 tyto nejdůležitější změny:

- předmět normy je změněn tak, aby zahrnoval všechny diskrétní polovodičové součástky pro povrchovou montáž s počtem vývodů vyšším nebo rovnému 8;
- ediční změny na několika stránkách; a
- technická úprava vzhledem k pouzdru typu ball grid array (BGA), zejména k jejich geometrickému formátu kreslení (dva typy pouzder BGA budou unifikovány jako jeden typ jako výsledek této revize).

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60191-1:2007 zavedena v ČSN EN 60191-1:2008 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 1: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder diskrétních součástek (idt EN 60191-1:2007)

IEC 60191-4:1999 zavedena v ČSN EN 60191-4:2000 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek – Část 4: Kódovací systém a rozřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek (idt EN 60191-4:1999)

ISO 1101:2004 zavedena v ČSN EN ISO 1101:2006 (01 4120) Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení (idt EN ISO 1101:2005)

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IČO: 00216305

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.